

SMD

尺寸2220 (EIA) 或5650 (IEC)

额定电感1 μ H至10000 μ H

额定电流25 mA至1800毫安



施工

- 直立式铁氧体磁芯
- 激光焊接绕组
- 阻燃成型

特点

- 温度范围可达150°C
- 电流处理能力高达1.8 A
- 高电感评级
- 符合AEC -Q200标准
- 适用于无铅回流焊
如引用在JEDEC J -STD 020C
- 符合RoHS标准

应用

- 电源电压滤波，耦合，去耦
- DC / DC转换器
- 汽车电子
- 电信
(如阻塞滤波器， 12位和16 kHz的脉冲计数)
- 消费类电子产品
- 工业电子产品

码头

- 基材CuSn6
- 层组合物，铜，银，锡 (无铅) 1)
- 电镀

记号

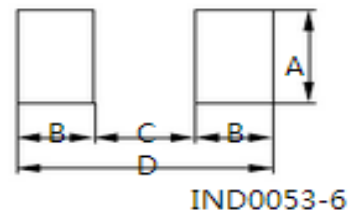
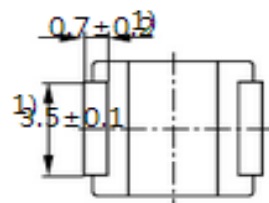
- 基于组件的标记：
制造商，L值 (μ H) ，
L值 (编码) ，生产日期的耐受性 (YWWD)
- 盘上最小的数据：
制造商，订货代码，L值，数量，包装日期

分装方式及包装设备

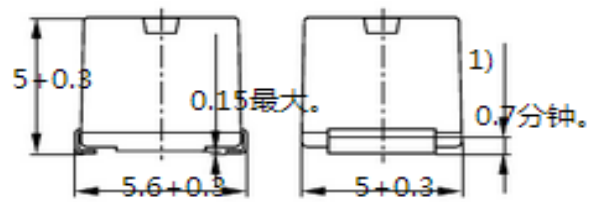
- 12毫米吸塑带，缠绕在330毫米 $\varnothing$ REEL
- 包装单位： 1500个/卷

SMD

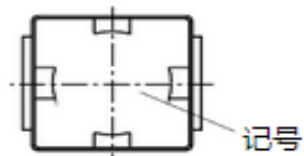
尺寸图和布局的建议



IND0053-6



A	B	C	D
4.5	2.0	4.0	8.0



1) 焊接区

IND0088-3-E 尺寸 (mm)

SMD
技术参数和测量条件

额定电感L	R	测量阻抗分析仪Agilent 4294A 在频率f _L , 0.1 V, 20°C
Q因子Q _民		测量阻抗分析仪Agilent 4294A 在频率f _Q , 20 °C
额定温度T	R	105 °X
额定电流I	R	最大允许的DC与电感下降 $\Delta L/L_0 \leq 10\%$ 和温度的增加 of $\leq 20K$ 的额定温度
自谐振频率f	水库, 分	测量网络分析仪Agilent 8753D, 20°C
直流电阻R	最大	测量20 °X
焊 (无铅)		Sn95.5Ag3.8Cu0.7 : $(\pm 5 \pm 0.3) s$ 润湿焊接区 $\geq 90\%$ (根据IEC 60068-2-58)
焊锡耐热性		260 °X, 40秒 (以引用的JEDEC J-STD 020C)
气候类别		55/150/56 (符合IEC 60068-1)
储存条件:		安装: -55 °C ~ +150°C 包装: -25 °C ... + 40 °C, $\leq 75\%$ RH下
重量		约. 0.4克